

证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2019-037

协鑫集成科技股份有限公司

第四届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十二次会议于2019年4月24日以电子邮件及电话方式通知全体董事,并于2019年4月30日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长主持,会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的有关规定,合法有效。经与公董事审议,通过如下决议:

一、会议以4票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》,关联董事朱共山先生、罗鑫先生、胡晓艳女士、张峰先生、宋明先生回避表决,根据公司2018年六次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,为保证公司本次非公开发行顺利进行,并结合公司实际情况,公司拟对本次非公开发行股票方案中的募集资金规模进行调整,具体内容如下:

调整前:

公司本次发行募集资金总额不超过500,000,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
大尺寸背阳晶半导体项目	273,230.00	256,000.00
C-Si材料深加工项目	73,584.00	69,000.00
半导体晶圆单晶炉及相关装备项目	50,076.00	26,000.00
补充流动资金	150,000.00	150,000.00
合计	546,890.00	600,000.00

除补充流动资金项目外,本次募集资金将全部用于投资上述项目的资本性支出部分,非资本性支出由公司通过自筹方式解决。募集资金到位后,公司可以根据募集资金投资项目的情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若本次实际募集资金金额(扣除发行费用)少于项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

除上述调整外,本次发行方案具体内容保持不变。

公司本次发行募集资金总额不超过423,200.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
大尺寸背阳晶半导体项目	273,230.00	256,000.00
C-Si材料深加工项目	73,584.00	69,000.00
半导体晶圆单晶炉及相关装备项目	50,076.00	26,000.00
补充流动资金	150,000.00	150,000.00
合计	546,890.00	600,000.00

除补充流动资金项目外,本次募集资金将全部用于投资上述项目的资本性支出部分,非资本性支出由公司通过自筹方式解决。募集资金到位后,公司可以根据募集资金投资项目的情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若本次实际募集资金金额(扣除发行费用)少于项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

除上述调整外,本次发行方案具体内容保持不变。

公司本次发行募集资金总额不超过423,200.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
大尺寸背阳晶半导体项目	273,230.00	256,000.00
C-Si材料深加工项目	73,584.00	69,000.00
半导体晶圆单晶炉及相关装备项目	50,076.00	26,000.00
补充流动资金	150,000.00	150,000.00
合计	546,890.00	600,000.00

除补充流动资金项目外,本次募集资金将全部用于投资上述项目的资本性支出部分,非资本性支出由公司通过自筹方式解决。募集资金到位后,公司可以根据募集资金投资项目的情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若本次实际募集资金金额(扣除发行费用)少于项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

除上述调整外,本次发行方案具体内容保持不变。

公司本次发行募集资金总额不超过423,200.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
大尺寸背阳晶半导体项目	273,230.00	256,000.00
C-Si材料深加工项目	73,584.00	69,000.00
半导体晶圆单晶炉及相关装备项目	50,076.00	26,000.00
补充流动资金	150,000.00	150,000.00
合计	546,890.00	600,000.00

除补充流动资金项目外,本次募集资金将全部用于投资上述项目的资本性支出部分,非资本性支出由公司通过自筹方式解决。募集资金到位后,公司可以根据募集资金投资项目的情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若本次实际募集资金金额(扣除发行费用)少于项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

除上述调整外,本次发行方案具体内容保持不变。

公司本次发行募集资金总额不超过423,200.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
大尺寸背阳晶半导体项目	273,230.00	256,000.00
C-Si材料深加工项目	73,584.00	69,000.00
半导体晶圆单晶炉及相关装备项目	50,076.00	26,000.00
补充流动资金	150,000.00	150,000.00
合计	546,890.00	600,000.00

除补充流动资金项目外,本次募集资金将全部用于投资上述项目的资本性支出部分,非资本性支出由公司通过自筹方式解决。募集资金到位后,公司可以根据募集资金投资项目的情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若本次实际募集资金金额(扣除发行费用)少于项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

除上述调整外,本次发行方案具体内容保持不变。

公司本次发行募集资金总额不超过423,200.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
大尺寸背阳晶半导体项目	273,230.00	256,000.00
C-Si材料深加工项目	73,584.00	69,000.00
半导体晶圆单晶炉及相关装备项目	50,076.00	26,000.00
补充流动资金	150,000.00	150,000.00
合计	546,890.00	600,000.00

除补充流动资金项目外,本次募集资金将全部用于投资上述项目的资本性支出部分,非资本性支出由公司通过自筹方式解决。募集资金到位后,公司可以根据募集资金投资项目的情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若本次实际募集资金金额(扣除发行费用)少于项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

除上述调整外,本次发行方案具体内容保持不变。

公司本次发行募集资金总额不超过423,200.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
大尺寸背阳晶半导体项目	273,230.00	256,000.00
C-Si材料深加工项目	73,584.00	69,000.00
半导体晶圆单晶炉及相关装备项目	50,076.00	26,000.00
补充流动资金	150,000.00	150,000.00
合计	546,890.00	600,000.00

除补充流动资金项目外,本次募集资金将全部用于投资上述项目的资本性支出部分,非资本性支出由公司通过自筹方式解决。募集资金到位后,公司可以根据募集资金投资项目的情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若本次实际募集资金金额(扣除发行费用)少于项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

除上述调整外,本次发行方案具体内容保持不变。

公司本次发行募集资金总额不超过423,200.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
大尺寸背阳晶半导体项目	273,230.00	256,000.00
C-Si材料深加工项目	73,584.00	69,000.00
半导体晶圆单晶炉及相关装备项目	50,076.00	26,000.00
补充流动资金	150,000.00	150,000.00
合计	546,890.00	600,000.00

除补充流动资金项目外,本次募集资金将全部用于投资上述项目的资本性支出部分,非资本性支出由公司通过自筹方式解决。募集资金到位后,公司可以根据募集资金投资项目的情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若本次实际募集资金金额(扣除发行费用)少于项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

除上述调整外,本次发行方案具体内容保持不变。

公司本次发行募集资金总额不超过423,200.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
大尺寸背阳晶半导体项目	273,230.00	256,000.00
C-Si材料深加工项目	73,584.00	69,000.00
半导体晶圆单晶炉及相关装备项目	50,076.00	26,000.00
补充流动资金	150,000.00	150,000.00
合计	546,890.00	600,000.00

除补充流动资金项目外,本次募集资金将全部用于投资上述项目的资本性支出部分,非资本性支出由公司通过自筹方式解决。募集资金到位后,公司可以根据募集资金投资项目的情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若本次实际募集资金金额(扣除发行费用)少于项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

除上述调整外,本次发行方案具体内容保持不变。

公司本次发行募集资金总额不超过423,200.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
大尺寸背阳晶半导体项目	273,230.00	256,000.00
C-Si材料深加工项目	73,584.00	69,000.00
半导体晶圆单晶炉及相关装备项目	50,076.00	26,000.00
补充流动资金	150,000.00	150,000.00
合计	546,890.00	600,000.00

除补充流动资金项目外,本次募集资金将全部用于投资上述项目的资本性支出部分,非资本性支出由公司通过自筹方式解决。募集资金到位后,公司可以根据募集资金投资项目的情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若本次实际募集资金金额(扣除发行费用)少于项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

除上述调整外,本次发行方案具体内容保持不变。